

证券代码：688603

证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场调研 ☐电话会议 ☐其他
参会单位	通过上证路演中心参与“2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会的公告”的投资者
调研时间	2025 年 9 月 10 日（周三）15:00-17:00
会议地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 董事会秘书、副总经理：费维 财务负责人：王晓花 独立董事：石建宾 首席技术官：韩佐晏
投资者关系活动主要内容记录	网络文字互动问答 （一）鉴于众多下游 PCB 工厂陆续宣布扩充产能，请问公司有何计划？ 答复： 尊敬的投资者您好，公司为匹配下游客户的产能扩充和日益增长的订单量，现已计划将金山工厂产能从年产 3 万吨功能性湿电子化学品提升至 4 万吨，此外珠海年产 3 万吨工厂建设将于近日开工以辐射华南区域的众多 PCB 下游工厂，泰国全资子公司年产 3 万吨工厂将于 26 年建成以具备对东南亚地区的供应能力，相关内容请关注公司于交易所发布的公告。感谢您的关注！ （三）领导您好，公司注册地址已从广东搬迁至上海，请问公司在上

海有何规划？

答复：

尊敬的投资者您好，公司于 2025 年 7 月 16 日正式落地上海张江，完成总部的迁址。同时公司在张江、金桥等上海浦东新区的集成电路核心区域布局研发中心和总部相关功能。公司拟全面、深度融入上海集成电路核心产业链，规划好现有产品的同时，在“卡脖子”材料领域积极布局，配合上海集成电路领域“强链补链”的任务并做出贡献。感谢您的关注！

（三）今年有哪些项目可以贡献收入和利润？

答复：

尊敬的投资者您好，公司今年的主要收入来自于高端 PCB、封装基板以及半导体先进封装，终端主要面向 AI 算力、人工智能、服务器、航空航天、汽车、通信众多等领域。公司产品已经导入行业主流和头部的 PCB 客户，在不断提升客户产品应用渗透率的同时，积极抓住当前 AI 带来的时代机遇，加大力度把握在以英伟达为代表的 AI 服务器领域的相关业务机会。PCB 产业正在加速迭代，当前已经到了 28 层 8 阶甚至 30 层 10 阶的技术发展阶段，包括封装上的玻璃基板材料，甚至是 COWOP 等最新的工艺思路都在不断被提出，PCB 整体从精密度、集成度各方面越来越靠近集成电路。天承科技核心研发团队沉淀 30 年的技术积累始终让公司可以抓住每一次技术迭代的机会。当前，公司在国内头部 AIPCB 客户处也取得了不错的验证进展，并在陆续上线产品，后续将为公司持续贡献收入和利润。此外，公司于去年成立了半导体事业部，新任 CTO 韩佐晏博士牵头推进公司半导体材料的研发和销售。半导体事业部当前布局了大马士革、TSV、TGV、RDL、bumping 等各类工艺的电镀液添加剂产品（包括铜镍、锡银），应用于前道晶圆制造、先进封装等领域，团队积极与存储&逻辑 fab、封装、面板、光电等各类头部客户互动，目前多家客户正在验证中并已经取得了部分订单，正在加速发展中。感谢您的关注！

（四）介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？

答复：

	尊敬的投资者您好，公司处于 PCB 行业中上游相对细分的功能性湿电子化学品材料领域，国内在该领域有一定规模的企业较少，且大多数的市场份额仍被国际巨头企业所把持，市场的潜在空间相对较大，公司也正在加速发展中。公司在过往定期报告中披露了与公司产品类似的同行业竞争对手公司，投资者可以通过相关资料以及公开信息查阅同行业其他企业的业绩表现，谢谢。
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 13 日